輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

メーカー名: 型及び銘柄: 2025.05.28施行政省令等対応(1/1) 次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの イ (16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置 双下の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、		貨物名:				
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの		メーカー名:				
2025. 05. 28施行政省令等対応(1/1) 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 7 - (16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 判 定 欄 注 釈 記 入 欄 [省令]第6条 輸出合別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	OCCUPE.	型及び銘柄:				
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 7- (16) <u>半導体素子</u> 、集積回路若しくは <u>半導体物質</u> の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの <u>部分品</u> 若しくは <u>附属品</u> [省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 十七 <u>半導体素子</u> 、集積回路若しくは <u>半導体物質</u> の製造用の装置						
7-(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは附属品 判定欄 注 釈 記 入欄 [省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。 該当〇 非該当 × 対象外 - 十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置であって、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは所属品 【】 数値()) 本古しくは所属品 [] 少 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜するように設計した装置であって、 次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) 《》 (一)ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 []除外数値(1	1			_
##						
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。 十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置 であって、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品 ソ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜する ように設計した装置であって、 次の全てに該当するもの(レ (二) に該当するものを除く。) (一) ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 該 当 ○ 非該当 × 対象外 − 【 】 数値 ()		判定欄	注釈	記	入 欄	
経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 井七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品						
次のいずれかに該当するものとする。 対象外 - 十七 <u>半導体素子</u> 、集積回路者しくは <u>半導体物質</u> の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置 であって、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの <u>部分品</u> 若しくは阻風品 数値(グ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜する ように設計した装置であって、 次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) (。) (一)ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [。] 数値()	[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の	該 当 〇				
十七 <u>半導体素子</u> 、集積回路者しくは <u>半導体物質</u> の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置 であって、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの <u>部分品</u> 若しくは <u>附属品</u> 数値(少 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜する ように設計した装置であって、 次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) (。) (一)ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [。] 数値()	<u>経済産業省令で定める仕様のもの</u> は、	非該当 ×				
(ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは阻風品 数値() グ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) ())) 除外 (一) ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	次のいずれかに該当するものとする。	対象外 -				
であって、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品 数値() ソ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜する [] 数値() ように設計した装置であって、 次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) 《 》]除外 (一)ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	十七 <u>半導体素子</u> 、集積回路若しくは <u>半導体物質</u> の製造用の装置	[]				
次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品 若しくは附属品 数値() ソ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) ()]除外 (一)ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	(ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置					
若しくは附属品 ソ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜する [] 数値() ように設計した装置であって、 次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) 《 》]除外 (一)ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	であって、					
ソ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜する [] 数値() ように設計した装置であって、 《 》]除外 (一)ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品					
ように設計した装置であって、 次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。) 《 》] 除外 (一) ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	若しくは附属品					
次の全てに該当するもの(レ (二) に該当するものを除く。) 《 》] 除外 (一) ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	ソ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜する	Г٦		数値()	
次の全てに該当するもの(レ (二) に該当するものを除く。) 《 》] 除外 (一) ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値()	ように設計した装置であって、					
(一) ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、化学的気相 [] 数値(« »	1 除外			
	200000000000000000000000000000000000000			数値 ()	
				然 框(,	
(二) ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、 [] 数値(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F 1		*6/== /	`	
		L J		~)	
133.3パスカル超53.33キロパスカル未満の圧力で 数値 ()				· · · · · ·)	
化学的気相成長法又は周期的堆積法によりタングステンの層を成膜するもの 数値()	化学的気相成長法又は周期的堆積法によりタングステンの層を成膜するもの			数値()	
判定結果 □該当 □非該当		判定結	丰果	□該当	□非該当	
作成責任者: (作成年月日: 年 月 日) 該当項番	作成責任者: (作成年月日: 年 月 日)	該当項番		<u> </u>		\neg
① 輸出令別表第1の項番[① 輸出令別表	長第1の項番	[]	
会 社 名 ② 貨物等省令の条項号等の番号等	会 社 名	② 貨物等省分	の条項号等の	の番号等		
	 -]]	
所属・役職 [所属・役職	[]	
	(a. II. 12. 1)					
(7 リ ガ †)						
氏 名	八 名					
電話	49 31					
电 的	电 前					